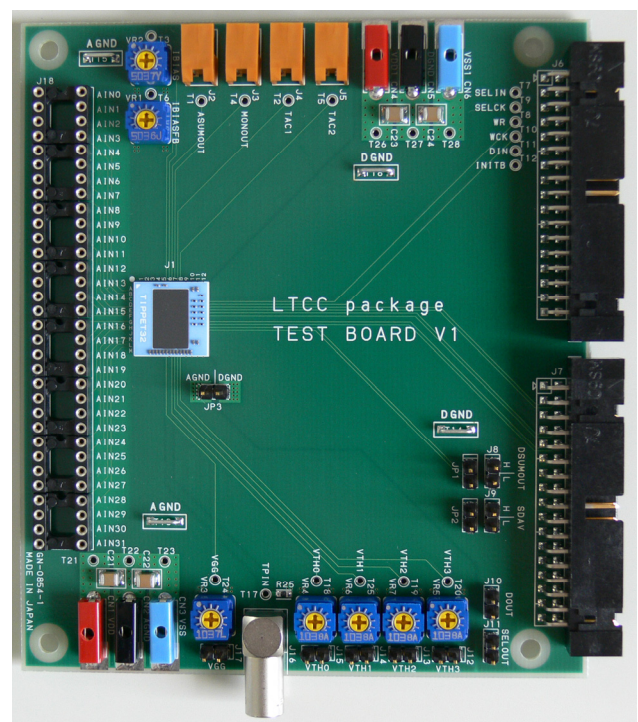


概説

近年のCCDやCMOSデバイスの技術革新により、デジタルカメラやスキャナーなど、様々な光センサーが身近なものとなってきた。陽電子断層撮影(PET)を含めた放射線計測も例外でなく、高感度光センサーの開発は時代が求める最先端のニーズである。本開発では、近年注目を集める「アバランシェ・フォトダイオード(APD)」に着目し、これを2次元アレー化してサブミリ分解能の撮像機能をもたせるほか、次世代PET開発に必要なあらゆる要素技術(データ処理、組み立て技術)を確立するものである。

今回開発した基板は、上記APDアレー専用開発したASICから信号を引き出すための小型専用パッケージであるLTCCパッケージの諸所の性能評価を行うための基板である。これにより、LTCCの雑音性やクロストークについての評価が可能となる。

開発の主体は 東京工業大学、宇宙航空研究開発機構です。



本プリント配線基板使用した 集積回路 装着写真

仕様

配線基板素材：FR4
層数：4層プリント配線基板
板厚：1.6mm
サイズ：100X115mm